

加工 (フォトリソ装置群)

スピコート

ミカサ社製 1H-DX2

仕様

形式	回転塗布式 1ヘッド
試料サイズ	最大 154 mmφ 1 mmt
試料固定方式	真空吸着方式
使用真空源	- 0.08 ~ 0.1 MPa
回転数	300 - 7000 r. p. m
回転精度	± 1 r. p. m
回転時間	最大 999.9 sec (合計)
回転制御	プログラム方式・最大100段入力可



スピコーティング

本装置は、シリコン基板等の薄膜基板上にフォトレジスト等をスピコートし薄膜を形成する装置です。回転数と回転時間を自在にプログラムできるため、様々な膜厚の薄膜を形成することができます。



スピコート前



スピコート後



「文部科学省ナノテクノロジープラットフォーム事業」

微細加工プラットフォーム・香川大学



お問い合わせ先

香川大学 産学連携・知的財産センター
ナノテクノロジー支援室

TEL/FAX: 087-887-1873

E-mail: nanoplatform-c@kagawa-u.ac.jp